

平成26年6月13日

<7月勉強会>

金型企業に代わって海外の仕事を探ってくる仕組み作りの第一弾

「半導体封止用金型」での提案説明会のお知らせ

一般社団法人日本金型工業会西部支部

支部長 堀口 展男

拝啓 時下益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。

また、日頃より工業会事業にご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。

さて、日本国内の金型需要は激減しています。一方、海外での金型需要は拡大するばかりの状況で、何とか海外の金型需要を国内に引き込みたいと思います。

つきましては、金型企業に代わって海外の金型の仕事を探ってくる仕組みが望まれています。

今回、それらの要望に応えるための提案がございましたので、仕事の内容は「半導体封止用金型」と限定されますが、まずは第一弾として以下の内容にて説明会を開催しますので、海外需要に取り組みたい、新しい市場の仕事に挑戦したい等にご興味のある方は、是非、ご参加下さい。

提案者ケイパブル社 (CAPABLE) 並びに提案の趣旨などについては別紙をご参照下さい。

敬具

記

■日 時 平成26年 7月25日 (金) 午後3時～5時

■場 所 大阪科学技術センタービル 6階602号室

〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル

駐車場が御座いませんので、公共交通機関をご利用下さいます様お願い申し上げます。

■内 容 半導体封止用金型の海外受注連携の提案

(1) 半導体封止用金型とは

(2) 提案内容の説明

説明者 株式会社CAPABLE (ケイパブル)

代表取締役社長 河原洋逸 様

(3) 質疑応答

(4) 個別相談も有り

■対象者 精密金型メーカー：1000分台の加工ができる金型・金属加工メーカー
(半導体封止用金型の製作実績は問いません)

■参加申込み方法 別紙参加申込書を7月10日までにFAXでお送り下さい

FAX 06-6479-1479 (一社)日本金型工業会西部支部 宛て

■問い合わせ先・申込先

一般社団法人日本金型工業会西部支部 吉田 電話 06-6479-1477

〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センター305号室

以上

株式会社CAPABLE（ケイパブル）並びに提案の趣旨

全世界の半導体封止金型業界で長年の経験と実績のあるエンジニアと営業スタッフ等により設立されたファブレス金型メーカーである（株）CAPABLEは、主に海外の半導体後工程工場から金型を直接受注し、自ら設計した図面を基に製作を日本の金型メーカーに依頼した上で、受け入れ検査・組立・試打ち・出荷及び製品保証等はCAPABLEで行うビジネスモデルを確立している。

海外の半導体封止金型市場では旺盛な需要があるものの、封止装置・金型を一貫生産しているオリジナルメーカーとそのコピーを作る地場の金型メーカーに仕事の流れ、日本の金型メーカーには殆ど仕事が回ってきていないのが現状である。

一方、半導体後工程工場では地場のコピー金型の品質に必ずしも満足しておらず、日本の優秀な金型に対する潜在的需要は大きい。

しかし、半導体後工程工場の技術的要求ハードルが高く、製品の信頼性評価を得るに時間がかかり、新規参入は容易ではないが（株）CAPABLEはすでに世界の主要半導体後工程工場との取引口座を開設している。

近い将来、半導体封止金型以外の海外の金型需要も日本国内の金型に繋ぐことも視野に入れている。

受注が確実に増えている昨今の状況下、新たな製作依頼先の金型メーカーとの協業を目指し、ビジネスモデルの詳細説明を行う。

対象者 精密金型メーカー：1000分台の加工ができる金型・金属加工メーカー
(半導体封止用金型の製作実績は問いません)



(FAX 06-6479-1479)
(一社) 日本金型工業会西部支部
「半導体封止用金型での提案説明会」
参加申込書

お名前	
会社名	
TEL	
FAX	
E-mail	
ご所属/ご役職	
備考	



地下鉄御堂筋線
「本町駅」
2番出口より西
へ徒歩7分

地下鉄四つ橋線
「本町駅」
28番出口より
北へ徒歩3分

「大阪科学技術
館」の看板が目
印です。そちら
にお入り下さい

駐車場が御座いませんので、公共交通機関をご利用下さいます様お願い申し上げます。